

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION .19
 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
ES	00	D4 REVISED ECR-17-010413	20JUL17	T.Z	H.W

15.71 REF
12.04 REF

0.92 ± 0.08 DIA
 $\oplus \varnothing 0.1 \text{ (M) A (S) B (S)}$
 4 PLC
 2.3 ± 0.08 DIA
 $\oplus \varnothing 0.1 \text{ (L) X (Y)}$
 -A- 2 PLC
 PIN2 PIN1
 PIN3 PIN4
 2.5
 X.XX 3
 -B-
 4.71
 2.71
 4.77
 12.04
 -X- 3
 -Y- 3

PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS 4

1 MATERIAL:
 1 SHELL : STAINLESS STEEL.
 CONTACTS: COPPER ALLOY.
 HOUSING: UL 94V-0 RATED, THERMOPLASTIC, BLACK.

2 PLATING:
 CONTACTS: 0.076 μm MINIMUM GOLD OVER 0.76 μm MINIMUM PALLADIUM-NICKEL ON MATING AREA.
 3.8 μm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS.
 BOTH OVER 1.27 μm MINIMUM NICKEL.
 CONTACT ALTERNATE PLATING: 0.76 μm MIN GOLD ON MATING AREA, 3.8 μm MIN MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER 1.27 μm MIN NICKEL.
 SHELL: 2.0~5.0 μm MINIMUM TIN.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.

5 PLATING:
 CONTACTS: 0.76 μm MINIMUM GOLD ON MATING AREA, 3.8 μm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER 1.27 μm MINIMUM NICKEL.
 SHELL: 2.0~5.0 μm MINIMUM TIN.

6 PLATING:
 CONTACTS: 0.38 μm MINIMUM GOLD ON MATING AREA, 3.8 μm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER 1.27 μm MINIMUM NICKEL.
 SHELL: 2.0~5.0 μm MINIMUM TIN.

7 RECOMMEND:
 MATING FORCE: 35N MAX.
 UNMATING FORCE: 13N MIN.
 RECOMMENDED MATING PLUG SHOULD MEET USB2.0 STANDARD.

12.03
8.45
11.05
7.78
2.5 REF
CONTACT TYP

SHELL
 X
 11.5 REF
 3.93 REF
 2 PLC
 10.28 REF
 2 PLC
 3.01 ± 0.25
 2 PLC
 SOLDER TAIL TYP

6.98 ± 0.25

SECTION X-X

6	NO	BLACK	292304-5
5	NO	BLACK	292304-4
2	YES	BLACK	292304-3
2	YES	NATURAL	292304-2
2	NO	BLACK	292304-1
PLATING	HIGH TEMPERATURE COMPATIBLE	HOUSING COLOR	PART NUMBER

<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.</small>		DWN J.JIANG 23FEB04	Tyco electronics coporation Shanghai, P.R.China, 200233
DIMENSIONS: mm		CHK S.YAO 23FEB04	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.1 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 2		APVD T.SASAKI 23FEB04	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, 4 POSITION, THRU-HOLE, TYPE B UNIVERSAL SERIAL BUS, LEAD FREE VERSION
MATERIAL 1		PRODUCT SPEC -	SIZE A2
		APPLICATION SPEC -	CAGE CODE 00779
		WEIGHT -	DRAWING NO C-292304
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1
			SHEET 1 OF 1
			REV D4

AMP 1471-9 REV 10/93 Translated 040217.101735 (YYMDD.HHMMSS) from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T

292304

B

A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9